

工程材料 第四章 固體中之不完美性 (Imperfections in Solid)

第四章 固體中之不完美性(Imperfections in Solid)

4.1 简介

- ●所有材料都會含有大量不同種類的缺陷或不完美性,缺陷的影響並非都是不好
- ●「晶體缺陷」, 晶體的不完美性包括點缺陷(1~2個原子位置)、線缺陷(或一維)和二維的界面缺陷或邊界缺陷

4.2 金屬中的點缺陷

●最簡單的點缺陷為空位或空晶格位置如圖4.1,所有結晶固體 皆有空位



圖 4.1 一空位和一自間隙原子之二維表示。



 $N_{\nu} = N \exp((-Q_{\nu}/kT))$ (4.1)

式中N是原子位置的總數,Q₂是形成一個空位所需的能量,T為絕對溫度(以K表示),且k是氣體或波茲曼常數(Boltzmann's constant)。K的值為1.38×10-23 J/atom-K或8.62×10-5 eV/atom-K,其Q₂與單位有關。空位的數目隨溫度增加而以指數方式增加

- 一自間隙原子是一原子由晶格位置上擠到間隙的位置,而 此間隙之小空隙在正常情況下是不被原子所佔據,這種缺 陷亦表示於圖 4.1 中。
- 在金屬中,由於置換式原子大於間隙式原子的位置,因此,自間隙原子會在周圍的晶格引入相對大的畸變,此種 缺陷形成的可能性不高

計算銅在 1000 ℃ 時每立方米中空位的平衡數目。空位之形成能是 0.9 eV/atom; 銅的原子量和密度 (在 1000 ℃)分別是 63.5 g/mol 和 8.4 g/cm³。

<u>解:</u>

@卿卿 4.1

此問題可使用式 (4.1) 來解答;但首先必須決定 N 值,對銅而言可利用其原 子量 A_{Cu}、密度 ρ 和亞佛加厥數 N_A 來計算每立方米中原子位置的數目 (N),計算 式為

$$\rho = \frac{nA}{V_C N_A} \qquad N = \frac{N_A \rho}{A_{Cu}}$$

$$= \frac{(6.023 \times 10^{23} \text{ atoms/mol})(8.4 \text{ g/cm}^3)(10^6 \text{ cm}^3/\text{m}^3)}{63.5 \text{ g/mol}}$$

$$= 8.0 \times 10^{28} \text{ atoms/m}^3$$

$$B \text{L} \cdot \text{E} \ 1000 \,^{\circ}\text{C} \ (1273 \text{ K}) \text{ B} \text{Z} \text{E} \text{C} \text{B} \text{B} \text{B} \text{B}$$

$$N_{\nu} = N \exp\left(-\frac{Q_{\nu}}{kT}\right)$$

$$= (8.0 \times 10^{28} \text{ atoms/m}^3) \exp\left[-\frac{(0.9 \text{ eV})}{(8.62 \times 10^{-5} \text{ eV/K})(1273 \text{ K})}\right]$$

$$= 2.2 \times 10^{25} \text{E} \text{C} \text{/ m}^3$$

$$(4.2)$$



金屬中的雜質

- 純金屬中不可能僅含有一種原子,因當中總會有雜質或外來原子的存在,且有些會以晶體點缺陷方式存在。大部份熟悉的不是高純度的金屬,而是為合金,它們是刻意將雜質原子滲入以得到某種材料特性。通常合金加入金屬中用以增進機械強度和耐腐蝕性,如92.5% 銀-7.5% 銅合金。
- 雜質原子添加到金屬中將會產生固溶體(solid solution)和
 第二相(second phase)的形成,其取決於雜質的種類、濃度及合金的溫度而定
- 對合金來說,溶質(solute)和溶劑(solvent)是常用的名詞。「溶劑」代表固溶體中量較多的元素或化合物;有時溶劑原子亦稱為母原子。而「溶質」則被用來表示固溶體 中濃度較少之元素或化合物

固溶體 (Solid Solution)

- 當溶質原子添加至母材中,晶體結構維持不變且無新結構
 形成時,變形成一固溶體。如果兩液體混合時可彼此互溶
 (如水和酒精)。一固溶體之成份也會均勻分佈,在固體
 中雜質原子是散亂且均勻的分佈於其中
- 於固溶體中發現的雜質點缺陷,其有兩種形式:置換式和 插入式
- ▶ 對置換式固溶體而言,溶質或雜質原子取代或置換原子 (圖4.2)。



- ●有數個關於溶質和溶劑原子的特徵,可用來決定前者溶於 後者的程度;這些特徵如下:
- 1.原子尺寸因素:當兩種原子間的原子半徑差距小於約±15時 2.晶體結構:金屬中之兩種原子的晶體結構必須相同。
- 3.陰電性:其中一元素具有較大之正電性且另一元素有較大 之陰電性時,則它們之間形成金屬間化合物以取代形成置 換式固溶體的可能性會增加。
- 4.價數:一金屬溶解另一具有較高價數金屬的傾向會比另一 較低價數的金屬為大。
- ●銅和鎳為置換式固溶體的一個實例。這兩個元素可以在所 有的比例下都完全互溶。銅和鎳的原子半徑分別為0.128和 0.125 nm,二者皆具有FCC晶體結構,且它們的陰電性分別 為1.9和1.8(圖2.7),銅最普通的價數是+1價,而鎳為+ 2價。



圖 4.2 置換式雜質原子是溶質或雜質原子取代或替代了母 原子。間隙式雜質原子則是雜質原子填在母原子間 的間隙或空隙的位置。



- 間隙式固溶體而言,雜質原子充填於母子原子間的空位
 或格隙的位置(圖4.2)。
- 對較高原子堆積因子的金屬材料,這些間隙位置較小,因此間隙雜質的原子半徑必須較母原子來得小。
- 正常來說,間隙雜質原子的最大允許溶解濃度較低(小於10%),即使非常小的雜質原子一般還是較格隙位置為大。因此它們的導入會對周圍的母原子引起某種程度的晶格應變。
- 將碳加入鐵時,會形成間隙固溶體;碳的最大濃度約為2%。碳原子的原子半徑遠小於鐵原子:0.071 nm對 0.124 nm。



4.4 成分之規則

- 通常必須以合金中的組成元素來表示合金的成份(或濃度)。兩種最常用來表示成分的方法是重量(或質量)
 百分比和原子百分比。
- ●重量百分比為某特定元素的重量相對於總合金重量的 比。對一含有標為1和2的兩個假想原子的合金而言,1 的濃度以wt%(重量百分比 weight percent, wt%),且 定義成,,C₁,定義為:

 $C_1 = [m_1/(m_1 + m_2)] \times 100 \qquad (4.2)$

其中 m_1 和 m_2 分別代表元素1和2的重量, C_2 濃度類似可計算



●原子百分比(at%)是一元素的莫耳數相對於合金中元素的總莫耳數之比。對某指定質量的假想元素1的莫耳數是n_{m1}

$$n_{m1} = m_1' / A_1$$
 (4.3)

 m_1 '和 A_1 分別表示元素1的質量(克)和原子量

 ●對含有1及2原子的合金中,以元素1的原子百分比來表示 濃度,C₁',

 $C_1' = [n_{m1}/(n_{m1} + n_{m2})] \times 100$ (5.3)

元素2的原子百分比亦可決定出



成分之換算(Composition Conversions)

。使用前節的慣例(即,重量百分比表成 C₁和 C₂,原子百分比
 以 C'₁和 C'₂來代表,和原子量表成 A₁和 A₂),這些轉換如下:

$$C_{1}' = \frac{C_{1}A_{2}}{C_{1}A_{2} + C_{2}A_{1}} \times 100$$
(4.6a)
$$C_{2}' = \frac{C_{2}A_{1}}{C_{1}A_{2} + C_{2}A_{1}} \times 100$$
(4.6b)
$$C_{1} = \frac{C_{1}'A_{1}}{C_{1}'A_{1} + C_{2}'A_{2}} \times 100$$
(4.7a)
$$C_{2} = \frac{C_{2}'A_{2}}{C_{1}'A_{1} + C_{2}'A_{2}} \times 100$$
(4.7b)

由於我們僅考慮兩個元素,所以涉及前面方程式之計算可簡化成

$$C_1 + C_2 = 100 \tag{4.8a}$$

$$C_1' + C_2' = 100 \tag{4.8b}$$

此外,有時變成必須由重量百分比轉變成每單位材料的體積中某一成 分的質量(即,從wt%之單位變到kg/m³);後者之成分表示式常用於 擴散之計算(5.3節)。根據此基礎濃度將使用兩撇(即C₁"和C₂")來表 示,且相對方程式如下:

$$C_{1}'' = \left(\frac{C_{1}}{\frac{C_{1}}{\rho_{1}} + \frac{C_{2}}{\rho_{2}}}\right) \times 10^{3}$$

$$C_{2}'' = \left(\frac{C_{2}}{\frac{C_{1}}{\rho_{1}} + \frac{C_{2}}{\rho_{2}}}\right) \times 10^{3}$$
(4.9a)
(4.9b)

密度 ρ 的單位是 g/cm³,這些表示式使得 C_1'' 和 C_2'' 以 kg/m³ 來表示。

分別以 Pave 和Aave 來表示合金的密度和原子量,則



必須注意式 (4.9) 和 (4.11) 並不完全正確,因在其推導過程中,是假設總合金的體積恰好等於個別元素的體積和。



圓 4.2

<u>解:</u>

為了簡化此推導,將假設質量以克的單位來表示,且使用一撇來表示 (例如 m'_),此外,總合金質量 (克) M' 是

$$M' = m_1' + m_2' \tag{4.12}$$

使用 C' 的定義 (式 (4.5)) 並合併式 (4.4) n_{m1} 之表示式,和類比之 n_{m2} 表示 式產生

$$C_{1}' = \frac{n_{m1}}{n_{m1} + n_{m2}} \times 100$$

= $\frac{\frac{m_{1}'}{A_{1}}}{\frac{m_{1}'}{A_{1}} + \frac{m_{2}'}{A_{2}}} \times 100$ (4.13)

式 (4.3) 中質量以克表示後重新整理可得

$$m_1' = \frac{C_1 M'}{100} \tag{4.14}$$

(4.15)

將此表示式和相當的 m'2 表示式代入式 (4.13) 可得

$$C_1' = \frac{\frac{C_1 M'}{100A_1}}{\frac{C_1 M'}{100A_1} + \frac{C_2 M'}{100A_2}} \times 100$$

簡化上式可得

$$C_1' = \frac{C_1 A_2}{C_1 A_2 + C_2 A_1} \times 100$$

此與式 (4.6a) 相同。

決定出由 97 wt% 鋁和 3 wt% 銅所組成的合金的成分 (以原子百分比表示)。

<u>解</u>:

@.圆 4.3

若我們將成分中個別的重量百分比表示成 $C_{Al} = 97$ 和 $C_{Cu} = 3$,將其代入式 (4.6a) 和 (4.6b) 可得

$$C'_{Al} = \frac{C_{Al}A_{Cu}}{C_{Al}A_{Cu} + C_{Cu}A_{Al}} \times 100$$

= $\frac{(97)(63.55 \text{ g/mol})}{(97)(63.55 \text{ g/mol}) + (3)(26.98 \text{ g/mol})} \times 100$
= 98.7 at%

和

$$C'_{Cu} = \frac{C_{Cu}A_{Al}}{C_{Cu}A_{Al} + C_{Al}A_{Cu}} \times 100$$

= $\frac{(3)(26.98 \text{ g/mol})}{(3)(26.98 \text{ g/mol}) + (97)(63.55 \text{ g/mol})} \times 100$
= 1.30 at%

各種不完美性(Miscellaneous Imperfections) 4.5 差排-線缺陷(Dislocatiobs -Linear Defects)

●差排是一種線性或一 維的缺陷,圍繞其周 圍的一些原子會排列 错误。其中一差排形 式顯示於 4.3 圖。稱 之為刀差排(edge dislocation);它是 一種線缺陷,其中心 圍繞著一條線,此線 為沿原子額外半平面 的终止部位,這條線 有時稱為差排線。











刃狀差排 B



圖 4.3 圍繞刃狀差排的原子位置,原子的多餘半平面以透 視畫法來表示。差排定義成沿原子的額外半平面的 端部的部份,對差排而言,差排線垂直於頁面。

對圖 4.3 中的刀狀差排而
 言;差排線垂直於頁面。在
 圍繞差排線的區域範圍內會
 有一些局部的晶格畸變。此
 畸變的大小隨著遠離差排線
 得距離而減小;在遠處時,
 晶格實際是完美的

●圖4.3 的刃差排有時以符號
 → 來表示,其亦可指出差排
 線的位置(晶體底部刃狀差
 排一)。





- 另外一種形式的差排稱 為螺旋差排,它可想像 成藉由剪應力作用產生 如圖4.4a中的畸變所形 成的
- 晶體的上面前方區域相 對於底部向右移動一原 子距離



圖 4.4 晶體內的螺旋差排



●螺旋差排伴隨的原子畸變亦是線性的(如沿圖4.4b中AB線段的差排線)。螺旋差排名稱來自圍繞差排線原子的原子平面路徑為螺旋形的,有時用С符號來表示螺旋差排





关排线

布格向量



圖 4.4(b) 是從圖 4.4(a) 上面觀察之螺旋差排,其原子畸變是線性的且差排沿線 AB 延伸。



- ●在結晶材料中同時 顯示兩種形式的分 量,這種差排稱為 混合差排。
- 所有三種形式差排的概略圖示於圖
 4.5,兩個以外其餘位置所產生的晶格
 畸變是混合型的,它具有不同程度之
 螺旋型和刃型的特性



圖 4.5 (a) 具有刃狀, 螺旋型和混合型特性的差排概略示意圖



圖 4.5 (b) 上視圖,其圓圈表示滑移平面上之原子位置,實心 圓圈表示滑移面下方之原子位置。在點A,差排是純螺旋 型;點B,則是純刀狀型,兩者間的區域,在差排線上是 彎曲的,此差排之特性為刃型和螺旋型的混合。 伴隨差排所產生晶格畸變的大小和方向可利用布格向量來 表示,以b來表示。圖4.3和4.4分別為刃差排和螺旋差排 的柏格向量。差排的種類可由差排線和柏格向量的相對方 向來定義。對刃差排來說,它們是互相垂直的(圖4.3), 螺旋差排是相互平行(圖4.4);而混合差排,它們則是不 相互垂直也不相互平行。





- 即使在晶體內差排改變方向和種類,則沿差排線上所有位置的布格向量仍會保持不變。
- 對金屬材料而言,差排的 布格向量將會指向最密堆 積的結晶學方向,且其大 小與原子間距相等。





- 差排可利用電子顯微鏡技術在 結晶材料中觀察到,圖4.6,其 中暗線即為差排。
- 圖 4.6 利用電子顯微鏡技術可觀 察到結晶材料中的差排, 圖 4.6 中是鈦合金之穿透 式電子顯微鏡之照片,其 中暗線部份是差排



幾乎所有的結晶材料都會包含一些插排,這些插排是於凝固期間、塑性變形期間何快速冷卻所導致熱應力的結果



4.6 界面缺陷 (Interfacial Defects)

界面缺陷是為邊界,邊界是一種二維且是分開具有不同晶 體結構和(或)結晶方向的材料區域。這些不完美性包括 外表面、晶界、雙晶界、疊差和相邊界。

● 外表面

▶ 最明顯的邊界之一是外表面,也就是沿著外表面晶體結構終止處。在表面位置的原子較位於內部的原子處在較高的能量狀態<這些表面原子的鏈結沒有飽和而引起表面能,以每單位面積的能量單位來表示(J/m²或erg/cm²)。為降低此能量材料可能傾向檢低總面積。



晶界 (Grain Boumdaries)

- 另一種界面缺陷,晶
 界是多晶材料中分分
 開兩個小晶粒或具有
 不同結晶方向的邊
 界,如圖 4.7。
- 在鄰近晶粒間可能會 有不同程度的結晶學 錯排,當這方向的差 異很小、在幾度大小 之間時,則以小角度 晶界(small angle grain boundaty)或者 以大角度經界存在。



- 當刀狀差排以圖 4.8 的方式排列時,就形成一簡單的小角度晶界,這種晶界稱為 傾斜晶界(tilt boundary);角度θ示於圖中。
- ●當方向差的角度平行於邊界時, 則產生可由螺旋差排來描述的 扭轉邊界(twist boundary)。
- 沿晶界處,原子間鍵結的規則性較低,因此表面能之界面能或晶界能存在。此能量的大小示方向差角度的函數,對高角度晶界而言有較高的能量。



圖 4.8 展示一傾斜邊界如何由任狀插 排的排列而導致方向差的角度



- 由於這邊界能的存在,使得晶界較晶粒本身具有較高之化學 反應性,此外由於它們較高能態,所以雜質原子常喜歡沿這 些邊界偏析。
- 由於大或粗晶粒的材料較細晶粒者的總界面低,此乃因為前者有較少的總邊界面積。在高溫下晶粒成長已降低邊界能。

學晶界 (Twin Boundaries)

- ▶ 攣晶界是一種特殊形式的晶界,通過攣晶界會有特殊的鏡面 晶格對稱;也就是說在晶界另一邊的原子會位於這一邊原子 的鏡像位置(圖4.9) ^
- ▶這些邊界間的材料在 區域稱為學品。
- ▶學晶的產生是經由施 加機械剪刀所造成原 子位移的結果(機械 學晶)和加工變形後 後的退火熱處理而產 生。



圖 4.9 顯示一雙晶平面或邊界以及鄰 近原子的位置



- ▶ 攣生發生於一明確的結晶平面和一特定方向,兩者取決於 晶體結構。退火攣晶典型地發現於具有FCC晶體結構的金屬 中,而機械攣晶則在BCC和HCP金屬中可被觀察到。
- 各種的界面缺陷(Miscellaneous Interfacial Defects)
- ▶其它可能的界面缺陷還包括疊差、相邊界和鐵磁區壁。
- ▶疊差(stacking fault)發現於FCC金屬中最緊密堆積平面, 當FCC中ABC ABC ABC...的堆積順序中斷時,則有疊差產 生。
- ▶相界(phase boundaries)存在於多相材料中,當通過相界時 在物理和化學特性上會有突然變化
- ▶對鐵磁性和亞鐵磁性材料而言,分開具有不同慈化方向區 域的邊界稱為慈區壁(domain wall)



4.7 體缺陷(Bulk or Volume Defects)

包括孔洞、裂缝、外來的介在物和其他相。它們通常是在製程和製造過程期所引入的。

4.8 原子的振動(Atomic Vibrations)

- ▶固體材料中的每一原子,於晶體內其晶格位置上非常快速的 振動。從某些角度來看,這些振動可視為不完美性或缺陷。 在任一瞬間不是所有原子都以相同的頻率和振幅大小作振 動,也不具相同的能量。
- ▶溫度上升平均能量上升,固體的溫度是原子或分子平均震動 活動的量測
- ▶固體的許多性質和製程是振動原子運動的一種表現。例如當振動大到足以破壞大多數原子鍵時,便發生熔融現象



4.9 晶粒尺寸大小之決定

- ●當考慮多晶材料的性質時,通常需要決定晶粒尺寸的大小。一些技巧可用來表示晶粒的大小,其中包括平均晶粒體積、直徑或面積。
- • 晶粒尺寸大小可利用如下描述的交截法來估算,算出每 一線段交截晶粒的個數;然後將線段長度除以交截的平 均晶粒數,且要將每一線段都計算。再將此結果除以照 片之線放大倍率,就可得到平均晶粒直徑。
- 大部分常用的方法是由美國材料試驗協會(ASTM)準備了 數種具有不同平均晶粒大小的標準比較圖,每張圖給一 個1到10其中的一個數目,稱為晶粒尺寸號碼(grain size number)。此號碼愈大,晶粒愈小。



- 通常試片的須適當的制備以顯示出晶粒結構,且在放大倍率為100倍時照相,顯微照片與ASTM晶粒尺寸號碼圖中的大小幾乎匹配時,晶粒大小可表示為晶粒號碼。
- 晶粒尺寸號碼與各終圖表背後的理論如下:令 n 表示晶粒 號碼,N表放大100 倍下每平方英吋的平均晶粒數,則此兩 參數間的關係為:

$$N = 2^{n-1} \tag{4.16}$$